

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司工业转型升级强基工程项目 通过正式验收及获得政府补助的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得政府补助的情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“本公司”）于近日收到工业和信息化部办公厅《关于 2019 年度工业强基工程实施方案验收评价结果（第一批）的通知》。公司负责的电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案（以下简称“项目”）通过工业和信息化部的正式验收。

该项目主要内容为：1、高频微波覆铜板；2、高密度封装覆铜板；实施目标为满足高频信号线路封装和载体（印制电路板）性能要求，实现工程化生产，基材国内市场占有率达 30~50%。在项目验收过程中，专家组听取了公司关于项目任务完成情况汇报，审核了有关资料，并对现场进行了考察及检测，一致认为，该项目达到了合同书中规定的技术考核指标，项目资金支出符合规定，且验收资料齐全，专家组一致同意项目通过正式验收。

该项目生产的电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板已经得到市场的认可，用户使用反映良好，可以替代进口，用于通信、功放、滤波器、高频头、基站天线等行业，实现我国高端电子覆铜板的国有化，打破了欧美的垄断，具有显著的战略意义。项目的顺利实施对公司未来发展也将产生积极影响。

公司已于2015年7月启动该项目审批并实施。根据合同约定，合同签定后当年内国家下达第一笔专项资金1,949万元（公司当期已收此款），项目正式验收通过后，公司可获得国家第二笔专项资金人民币1,651万元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助。公司收到与资产相关的政府补助，按照该资产预定可使用年限将递延收益平均分摊计入当期损益，预计本笔政府补助款影响本年度损益金额为101.08万元。上述政府补助的会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、风险提示和其他说明

截止本公告披露日，公司尚未收到上述政府补贴。该项目政府补助款项的实际拨付日期需经有关部门根据实际情况审核和拨付，存在一定的不确定性，公司将根据相关规定披露上述政府补助的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《工业和信息化部办公厅关于2019年度工业强基工程实施方案验收评价结果（第一批）的通知》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月22日